

金属・セラミックス焼結の基礎

日時 2016年7月27日(水) 13:00~16:30

主催 S&T出版株式会社

会場 高橋ビルディング (東宝土地(株)) 会議室 東京都千代田区神田神保町3-2

受講料 43,200円 Eメール案内会員価格 41,000円 ※資料代を含む

(税込)

<1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>

※2名様ご参加は同一会社・法人からの同時申込に限ります。

※2名様ご参加は2名様分の参加申込が必要で、必ず2名様のご参加はできません。

※3名様以上のご参加は追加1名様あたり10,800円OFFになります。

Eメール案内登録(無料)をしていただいた方はEメール案内会員価格を適用いたします。

講師 南口 誠 氏 / 長岡技術科学大学 大学院 技学研究院 機械創造工学専攻 材料システム工学大講座 教授

申込受付は終了しました

金属やセラミックスの製造方法として、焼結は広く利用されている。昨今では自動車産業などに焼結金属やセラミックスの利用が大がなされている。しかし、焼結は高度なノウハウを必要とする技術であるため、その背景にある基礎的な学問が重要視されていないところがある。本セミナーでは、金属やセラミックスの焼結に関する基本的な考え方とその実例を中心に解説するとともに、焼結の周辺技術や最近のトピックスについて述べる。

講演詳細

1. 焼結の基礎

- (1) 初期焼結
- (2) 中・終期焼結
- (3) 液相焼結

2. 拡散現象の基礎

- (1) 拡散機構
- (2) フィックの法則

3. セラミックスの欠陥化学

- (1) 材料欠陥の熱力学
- (2) 欠陥の酸素分圧依存性: Kroger-Vink図

4. 焼結の前工程

- (1) 粉末の準備: 粉碎, 混合, 造粒
- (2) 成形: 乾式成形・湿式成形

5. 種々の焼結方法

- (1) 大気焼結
- (2) 真空焼結、雰囲気焼結
- (3) 加圧焼結: ホットプレス、熱間等方加圧焼結

6. 焼結体の評価方法

- (1) 密度測定
- (2) 粒径測定
- (3) 組織観察

7. 最近の話題(事例紹介): パルス通電焼結, ナノコンポジットなど

8. まとめ

セミナー申込用紙 セミナー名: ST160727(金属・セラミックス焼結の基礎)

会社・団体名		TEL	
住所 〒		FAX	
①	氏名	部署・役職	
	E-mail		
②	氏名	部署・役職	
	E-mail		
支払方法		<input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 当日現金 ※銀行振込の場合は振込予定日を記載ください 月 日	
Eメール案内会員登録(無料)		Eメール案内(無料)に <input type="checkbox"/> 登録する <input type="checkbox"/> 登録済み	
<small>※E-mailアドレスが必須です。 ※右記に✓印をつけてご登録いただくと、この申込からEメール案内会員価格で申込できます。 ※Eメールでセミナー・書籍の最新情報をご案内致します。</small>		通信欄	

※左記ご記入の上、**FAX 03-3261-0238**までお申込みください。

■お申込み方法
必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。または当社ホームページからお申し込みください。

■受付完了のご連絡

受付完了後、3営業日以内に請求書、受講券、会場案内図を郵送いたします。※お申込み後7日以上経っても受講券・請求書がお手元に届かない場合は、弊社までご連絡ください。

セミナー申し込み後、受講をキャンセルされる場合は、必ず開催日前日から起算して10日前までにご連絡ください。それ以降のご連絡及び、当日欠席の場合、返金はいたしかねますので、代理の方のご出席をお願いいたします。代理の方も出席できない場合は資料の送付でも出席させていただきます。受講料未入金のまま当日ご欠席されてもキャンセルにはなりません。全額請求させていただきますので予めご了承ください。

■お支払

銀行振込にてお願いいたします。受講料のご入金は、開催日までお願いいたします。やむなく開催日以降にご入金の場合は、当日現金でお支払またはお申込みの際に振込予定日をご記入ください。銀行振込の場合、領収証の発行はいたしません。

■個人情報の取り扱い

ご記入の個人情報は、商品の発送、事務連絡、ご案内等に使用いたします。